

Title (en)

Heat shield element

Title (de)

Hitzeschildelement eines Hitzeschildes

Title (fr)

Élément de bouclier thermique

Publication

**EP 2236928 A1 20101006 (DE)**

Application

**EP 09155390 A 20090317**

Priority

EP 09155390 A 20090317

Abstract (en)

The element (1) has a heat shield plate (10) mounted on a carrier plate (5), where a hot side of the heat shield plate and a cold side of the carrier plate are mounted on a support structure. A through hole (11) mounts the shield plate on the carrier plate. A recess is provided in the carrier plate at a position corresponding to the through hole, and a mounting screw (2) is inserted through the through hole. Head of the screw is captured in a space formed by the recess, and a side of the shield plate faces the carrier plate. An independent claim is also included for a method for assembling a heat shield element.

Abstract (de)

Ein Hitzeschildelement (1) für einen eine Vielzahl benachbart an einer Tragstruktur (16) angeordneter Hitzeschildelemente aufweisenden Hitzeschild, wobei das Hitzeschildelement (1) eine Heißeite (9) und eine Kaltseite (4) aufweist, ist dafür vorgesehen, als ein abschließendes letztes Hitzeschildelement auf die Tragstruktur (16) montiert zu werden. Es ist vorgesehen, dass das Hitzeschildelement (1) eine die Heißeite bildende Hitzeschildplatte (10) und eine die Kaltseite bildende Trägerplatte (5) aufweist, wobei die Hitzeschildplatte (10) auf die Trägerplatte (5) montierbar ist. Zur Montage der Hitzeschildplatte (10) auf der Trägerplatte (5) ist wenigstens eine Durchbohrung (11) in der Hitzeschildplatte (10) vorgesehen. In der Trägerplatte (5) an einer zur Durchbohrung (11) der Hitzeschildplatte (10) korrespondierenden Position ist ferner eine Vertiefung (12) mit einer Durchbohrung vorgesehen, in welche die Befestigungsschraube (2) durchsteckbar ist, wobei der Kopf der Befestigungsschraube (2) in einem durch die Vertiefung (12) und die zur Trägerplatte (5) zugewandte Seite der Hitzeschildplatte (10) ausgebildeten Raum eingesperrt ist.

IPC 8 full level

**F23R 3/00** (2006.01); **F23M 5/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**F23M 5/04** (2013.01 - EP US); **F23R 3/002** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49963** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/24273** (2015.01 - EP US)

Citation (applicant)

- EP 1701095 A1 20060913 - SIEMENS AG [DE]
- EP 0558540 B1 19950614 - SIEMENS AG [DE]

Citation (search report)

- [X] WO 2008017550 A1 20080214 - ALSTOM TECHNOLOGY LTD [CH], et al
- [X] EP 0895027 A1 19990203 - ABB RESEARCH LTD [CH]
- [X] EP 0895028 A1 19990203 - ABB RESEARCH LTD [CH]
- [A] US 2004110041 A1 20040610 - MERRILL GARY B [US], et al

Cited by

EP2762782A1; CN103968422A; DE102010015263A1; DE102010015263B4; ITMI20122104A1; EP2741001A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 2236928 A1 20101006**; CN 102356277 A 20120215; CN 102356277 B 20141022; CN 103759293 A 20140430; EP 2409083 A2 20120125; EP 2409083 B1 20150729; RU 2011141839 A 20130427; RU 2515692 C2 20140520; US 2011318531 A1 20111229; WO 2010105709 A2 20100923; WO 2010105709 A3 20110414

DOCDB simple family (application)

**EP 09155390 A 20090317**; CN 200980158149 A 20091202; CN 201410058197 A 20091202; EP 09784070 A 20091202; EP 2009066243 W 20091202; RU 2011141839 A 20091202; US 200913255574 A 20091202